

2005年7月28日

株式会社 富士経済

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町

2-5 F・Kビル

TEL.03-3664-5811 FAX.03-3661-0165

URL : <http://www.group.fuji-keizai.co.jp/>

広報部 03-3664-5697

## 粘着剤・接着剤市場の調査を実施

総合マーケティングビジネスの(株)富士経済(東京都中央区日本橋小伝馬町 代表取締役 阿部英雄 03-3664-5811)は、建築・土木、包装・製本、繊維・皮革、自動車、電気・電子、医療などあらゆる分野で使用され、現代の産業社会に不可欠の材料である粘着剤・接着剤市場について調査を行い、その結果を調査報告書「2005年 粘・接着剤および応用分野の現状と将来展望」にまとめた。

### <調査結果の概要>

#### 1. 粘着剤・接着剤全体市場

2004年 3,450億円 2010年予測 3,990億円(対04年比 116%)

2004年の市場全体を金額ベースで見ると、電気・電子分野とその他分野で使用されるシリコン系接着剤の規模が、660億円と際立って大きい。次いで、建築・土木分野、合板・木工分野、電気・電子分野など多岐にわたって使用されているウレタン系接着剤が293億円で続いている。その他に合計金額が200億円を超える市場としては、エラストマー系ホットメルト(227億円) 酢酸ビニル系エマルジョン(224億円)が挙げられる。

#### 2. 粘着剤・接着剤分野別市場

##### 合板・木工分野

金額ベースで、2004年の合板・木工分野全体では412億円となっている。種類別ウエイトでは酢酸ビニル系エマルジョンが市場の21%、メラミン樹脂系が19%、ユリア樹脂系接着剤が14%と続く。

酢酸ビニル系エマルジョンは、シックハウス対策からノントルエンタイプが次々と製品化されており、今後も広がる傾向である。

メラミン樹脂系は、耐水性・耐熱性に優れているため、コンクリート型枠用合板や住宅地下用、建築物外装用合板など屋外や長時間湿潤状態の場所で多く使用されている。メーカー各社は、「シックハウス症候群」などの室内汚染対策として環境対応型製品の開発に注力していくと見られる。

ユリア樹脂系は、安価で使いやすく、接着性能に優れているため、建築内装材料や家具材料として多用されている。しかし、現在はフェノール樹脂系に代替が進んでいるため減少している。

フェノール樹脂系は、耐水性、耐候性、耐熱性に優れた性能を有するため、特類合板向けの接着剤として、構造用耐力部材や常時湿潤な環境下で使用されている。国産の合板との接着性が良いなどユリア樹脂などより優れた面が多く、しばらくはユリア樹脂系接着剤からの代替が進むとみられる。長期的に市場は拡大していくと見込まれるが、中国からの輸入合板が増加する可能性も高く、成長率はやや鈍化していくと考えられる。

##### 包装・製本・紙加工分野

2004年は全体で637億円となっている。粘着剤・接着剤の種類別ウエイトを見ていくと、軟包装材料向けのウレタン系接着剤が28%、エマルジョン形粘着剤21%、EVA樹脂系ホットメルト16%と続く。

ウレタン系接着剤は、広範な材料への接着性に優れ、原料の組み合わせ次第で硬化皮膜の厚さを自由設計でき、硬化物の耐水性、耐薬品性、耐低温性、耐衝撃性、耐疲労性なども優れている。食品包装向けでは市場はほぼ成熟している。非食品分野ではリサイクル・軽量化指向により、洗剤などの詰替え用ラミネート袋の増加により接着剤需要も増加している。

エマルジョン形粘着剤は、ラベル打抜き加工性に優れるため、両面テープやTAC紙、一般ラベルなどのラベル・シール用途が主流である。日本のラベル需要は横ばいであるが、中国ではスーパーの増加によりバーコード印刷も増え、インフラ整備が進むにつれてラベル需要も増えている。原料価格が高くなってきていることから、製品価格も上がってきている。

## 建築・土木分野

2004年は426億円となっている。種類別構成比では、エポキシ樹脂系33%、ウレタン系接着剤が17%、弾性接着剤が13%と3分野で60%以上を占めている。

エポキシ樹脂系は、絶縁性・耐久性・耐熱性・対磨耗性・耐薬品性に優れ、用途を問わず高い接着能力を有し、硬化剤、改質剤などの配合方法によって多様な使用環境・状況に対応できることから、建築用途での採用が大半を占めている。しかし最近では、エポキシ樹脂系から、振動吸収性に優れたウレタン系や弾性接着剤に代替する動きが加速している。

弾性接着剤は、繰り返し疲労に強く、また異種材同士の接着にも優れた特長を有する。昨今の建築需要低迷の折、接着剤に対する各種の規制が強化される中でも、弾性接着剤は環境対策品として需要を伸ばしている。今後は、原材料の低価格化による製品単価の低下に伴い、エポキシを中心とした従来からの接着剤に対するコスト競争力もアップしていく。振動吸収性や作業性、対環境性といった特性と相まって、エポキシ系接着剤をはじめとした他の建築・土木用接着剤からの代替が更に進行する見通しである。

## 電気・電子分野

金額ベースでは、2004年は1,055億円規模となっている。種類別構成比では、シリコン系接着剤47%、導電性接着剤が15%と続く。

シリコン系接着剤は、耐熱性と同時に放熱性に優れ、耐候性も良いことから、基板周辺部位など高機能な電子部品の中心材料として需要が増加している。現在は、基板部品などの接着・固定用が主力であるが、将来的にはLEDの市場拡大が進むと見られ、その巨大な用途需要に期待が集まっている。

導電性接着剤は、固着用の樹脂と導電用の金属を混合したペースト状の接着剤であり、鉛フリー、低温プロセス、フラックスレスなどの環境対応に優れている。そのため、はんだ代替の材料として電気・電子部品向けに使用されている。今後は、電子部品の小型化に伴い微少塗布化が進むものの、環境性能や電子部品向けの優れた機能特性を活かして対象用途の拡大が期待されている。特に次世代技術のナノインクジェットペーストやシリコンカーバイド製パワー素子の分野では主流の接着材料となる可能性が高い。

## 2.注目市場

### フェノール樹脂系

2004年 52億円 2010年予測 93億円(対04年比 179%)

国内市場は、一貫して10%以上の増加傾向で推移している。フェノール樹脂系が好調に推移している背景としては、ホルムアルデヒド放散量の少ない特性によって、環境意識の高まりとともに、ユリア・メラミン樹脂系からの代替需要が増加していること、及び国内のスギなどを原木とした針葉樹合板が増加していることが挙げられる。針葉樹はホルムアルデヒドの放散量が多いため環境対応に優れたフェノール樹脂系接着剤を採用する傾向が高くなる。海外ではアメリカ市場の拡大が続くと見られる。

### シリコン系接着剤

2004年 660億円 2010年予測 820億円(対04年比 124%)

国内市場は、2002年以降デジタル家電の伸長によって電気・電子分野の需要が増大している。今後も自動車の電装化(ハイブリッドカー、燃料電池車の普及)、電気・電子部品の高機能化、そしてLEDの爆発的な普及が期待されるなど、シリコン系接着剤の需要を押し上げる要因が多々潜在しているため、市場は年率3%から4%程度の伸びで拡大していくと見られる。

### EVA樹脂系エマルジョン

2004年 100億円 2010年予測 121億円(対04年比 121%)

可塑剤フリーの特性と組成や構造比率が目的・作業条件によって変更できるなどで、酢酸ビニル系接着剤やCR系溶剤からの代替により、2003~2004年、EVA樹脂系エマルジョン需要は回復し始めている。EVA樹脂系エマルジョンは環境負荷を与えず、組成や構造比率を変えることで高機能化が図れるため、新たな用途開拓が進み、今後市場は増加すると見込まれる。

<調査対象>

主成分	調査対象品目
ユリア樹脂	ユリア樹脂系接着剤
メラミン樹脂	メラミン樹脂系接着剤
フェノール樹脂	フェノール樹脂系接着剤
エポキシ樹脂	エポキシ樹脂系接着剤
エラストマー	C R系溶剤形接着剤、エラストマー系ホットメルト
アクリル系	粘着剤、アクリル樹脂系エマルジョン、瞬間接着剤、反応性アクリル樹脂系接着剤（S G A）
ウレタン系	ウレタン系接着剤、反応型ホットメルト、水性高分子 - イソシアネート系接着剤
酢酸ビニル	酢酸ビニル系エマルジョン
E V A樹脂	E V A樹脂系エマルジョン、E V A樹脂系ホットメルト
ポリエステル樹脂	ポリエステル系ホットメルト
オレフィン系	オレフィン系ホットメルト、 - オレフィン系樹脂系接着剤
ポリアミド	ポリアミド系ホットメルト
シリコーン	シリコーン系接着剤、弾性接着剤
その他	紫外線硬化型接着剤、可視光硬化型接着剤、嫌気性接着剤、導電性接着剤、耐熱・超耐熱接着剤

<調査方法>

弊社専門調査員による業界関係者との直接ヒアリング取材を原則とした調査および分析を実施

<調査期間>

2005年4月～6月

以上

資料タイトル：「2005 粘・接着剤市場および応用分野の現状と将来展望」
体 裁：A4判 319頁
価 格：100,000円（税込み 105,000円） CD-ROMセット価格 110,000円（税込み 115,500円）
調査・編集：富士経済 東京マーケティング本部 第3事業部 ケミカルグループ TEL:03-3664-5821（代）FAX:03-3661-9541
発 行 所：株式会社 富士経済 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町2 - 5 F・Kビル TEL03-3664-5811（代）FAX 03-3661-0165 e-mail:koho@fuji-keizai.co.jp この情報はホームページでもご覧いただけます。URL: <a href="http://www.group.fuji-keizai.co.jp">http://www.group.fuji-keizai.co.jp</a>